機械加工欠陥

【特徴】SRの中に気泡が複数巻き込まれている状 態の欠陥

【特征】在 SR 中吸附多个气泡的缺陷。

[Characteristics] More than one air bubble are entrapped in solder resist

【原因・判断ポイント・発生工程】 S R インクの粘 度不適や、印刷または塗布環境条件不適、印刷また は塗布後から乾燥までの保留時間不足などにより出 来たもの(SR印刷、塗布工程)

【原因、判断要点、发生工序】SR 油墨粘度不合适, 印刷或者涂布环境条件不合适、抑或印刷或者涂布后 到烘干的停留时间不足所引起的(SR 印刷、涂布工 序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment]

The defect is caused by use of improper solder resist ink viscosity improper and environmental condition for application, and insufficient holding time from application of ink to curing (Solder resist application process)



顕微鏡倍率× 50 显微镜倍率 × 50 Magnification: ×50



【コメント】 顕微鏡倍率×10 显微镜倍率 × 10 [Coments] Magnification: ×10

2-1-1-9 全体的 P SR 現像残り/整个板面的 PSR 显影不净 / Entirely underdeveloped photo solder resist

【特徴】PSRパターンコーナや、スルーホール内に、 全体的にPSRが残っている状態の欠陥

【特征】整个板面在 PSR 图形的拐角,或者通孔内等 残留 PSR 的缺陷。

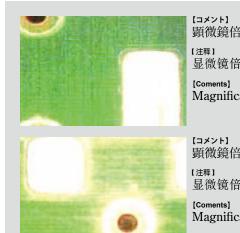
[Characteristics] Photo solder resist left on all over the conductor edges or the inside of through holes

【原因・判断ポイント・発生工程】PSR現像液の 劣化や、現像速度が早過ぎたりして、PSRが除去 しきれずに出来たもの(PSR現像工程)

【原因、判断要点、发生工序】PSR 显影液变质或者 显影速度太快,不能完全地除去 PSR 所造成的 (PSR 显影工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment]

The defect is caused by incomplete removal of photo solder resist due to a deteriorated develop solution or a too high developing conveyor speed (Photo solder resist development process)



顕微鏡倍率× 100

显微镜倍率 × 100

Magnification: ×100

顕微鏡倍率× 100 显微镜倍率 × 100

Magnification: ×100